

本件は、本日、韓国、米国においても発表いたします。

2012年1月19日

韓国企業をダイボンディングフィルムに関する特許権侵害で提訴

日立化成工業株式会社(本社:東京、執行役社長:田中 一行、資本金:155億円)は、INNOX Corporation(本社:韓国忠清南道牙山市、以下、INNOX)が、半導体パッケージ工程に使用するダイボンディングフィルムに関する当社の台湾特許を侵害しているとして、台湾の知的財産裁判所に提訴しました。

ダイボンディングフィルムは、多段積層化が進む半導体チップの接着に不可欠な超薄型フィルム状接着剤であり、半導体パッケージの高密度化や生産性向上に寄与します。当社は、1993年に他社に先立ち、ダイボンディングフィルムの開発に成功し、販売を開始しました。現在、ダイボンディングフィルムは半導体積層技術のデファクトスタンダードとなっており、当社はダイボンディングフィルム、ダイシング・ダイボンディング一体型フィルム等をラインアップしており、ワールドワイドでトップシェアを有しています。当社は、ダイボンディングフィルム、ダイシング・ダイボンディング一体型フィルム分野において、フィルム物性特許や、材料・パッケージに関する特許を含む約500件の多面的な特許網(特許出願中および台湾特許第I298084号を含む)を国内外に構築しています。

INNOXのWL-0020-05Aという製品は、INNOXが製造したダイシング・ダイボンディング一体型フィルムであり、当社の分析により、当社の台湾特許第I298084号の請求項1に入る疑いがあり、INNOXが当該製品を台湾において販売、または、販売の申し出をすることは、当社の台湾特許第I298084号の特許権侵害にあたります。

当社は、INNOXに対し、当社の保有する韓国特許に基づき特許侵害を警告する書簡を送付したことがあり、2011年4月にINNOXと協議を行いましたが、話し合いによる解決は見込めないとの結論に至りました。そこで、当社の知的財産を保護するため、台湾においてWL-0020シリーズの製品に関し、INNOXを提訴しました。

当社は、今後も知的財産面からの事業の優位性を図るため、知的財産を保護し、積極的に権利行使していきます。

以上